

平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月28日

上場会社名 株式会社トーメンデバイス 上場取引所 東

コード番号 2737

URL http://www.tomendevices.co.jp/

代表者

(役職名) 代表取締役社長

(氏名) 妻木 一郎

TEL 03-3536-9150

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 山口 孝

四半期報告書提出予定日

平成27年11月13日

配当支払開始予定日 -

四半期決算補足説明資料作成の有無:有

四半期決算説明会開催の有無:有(機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日~平成27年9月30日)

(1)連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	102, 383	21.3	1, 343	9. 7	1, 152	8. 3	777	14. 7
27年3月期第2四半期	84, 374	6. 4	1, 224	△23. 0	1, 064	△17.9	677	△3.6

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 850百万円 (37.6%) 27年3月期第2四半期 618百万円 (△41.5%)

	1 株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円銭	円 銭
28年3月期第2四半期	114. 29	103. 74
27年3月期第2四半期	99. 68	86. 60

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
28年3月期第2四半期	67, 376	25, 215	37. 3	3, 695. 60
27年3月期	54, 603	24, 637	45. 0	3, 612. 04

(参考)自己資本

28年3月期第2四半期

25.135百万円

27年3月期

24.567百万円

2. 配当の状況

		年間配当金								
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計					
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円銭					
27年3月期	_	0.00	_	40. 00	40.00					
28年3月期	_	0.00								
28年3月期(予想)			-	40. 00	40.00					

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無:無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上	高	営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
通期	174, 000	1. 2	2, 000	△17.9	1, 600	△4.8	1, 100	4. 2	161. 73	

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無:無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動):無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用:有
 - (注)詳細は、添付資料2ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(1)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご参照下さい。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :無② ①以外の会計方針の変更 :無③ 会計上の見積りの変更 :無④ 修正再表示 :無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期2Q	6, 802, 000株	27年3月期	6, 802, 000株
28年3月期2Q	438株	27年3月期	438株
28年3月期2Q	6,801,562株	27年3月期2Q	6, 801, 599株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。

○添付資料の目次

1.	当四半期決算に関する定性的情報	2
	(1) 経営成績に関する説明	2
	(2) 財政状態に関する説明	2
	(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2.	サマリー情報 (注記事項) に関する事項	2
	(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
	(2) 追加情報	2
3.	四半期連結財務諸表	3
	(1)四半期連結貸借対照表	3
	(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
	四半期連結損益計算書	
	第2四半期連結累計期間	4
	四半期連結包括利益計算書	
	第2四半期連結累計期間	5
	(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
	(継続企業の前提に関する注記)	6
	(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
4.	補足情報	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、徐々に回復を続けました。設備投資は、企業収益が明確な改善を続けるなかで、なだらかな増加基調にあり、個人消費も雇用・所得環境の着実な改善を背景に底堅く推移しました。一方、海外経済は、新興国が減速していますが、先進国を中心とした緩やかな成長が続いております。

エレクトロニクス業界におきましては、中国経済の減速の影響もあり、同国のスマートフォン関連需要は伸び悩んでおり、8月の世界半導体出荷金額が3ヵ月連続で前年同月比マイナス成長となるなど、半導体市況は一段と厳しく推移しております。その一方で、4 K、ハイレゾ対応等、新機能や高機能スマートフォン対応の部品需要は伸びております。

このような状況下、当社グループは、国内ではサーバー向けにDRAM、スマートフォン・タブレット向けに有機ELをそれぞれ拡販いたしました。また中国市場では、景気減速により全体的に需要が伸び悩む中、スマートフォン向けにCIS(CMOSイメージセンサ)、テレビ用液晶パネルの売上をそれぞれ伸ばしました。これらの結果、売上高1,023億83百万円(前年同期比21.3%増)、営業利益13億43百万円(前年同期比9.7%増)、経常利益11億52百万円(前年同期比8.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益7億77百万円(前年同期比14.7%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、673億76百万円(前連結会計年度末比23.4%増)となりました。これは主に預け金が増加したことによるものです。当社は豊田通商グループのキャッシュマネジメントシステムに参加し、一時的に生じた余資をこれに預け入れることにより運用しております。一方、負債は421億60百万円(前連結会計年度末比40.7%増)となりました。これは主に買掛金及び未払金の増加によるものです。純資産は252億15百万円(前連結会計年度末比2.3%増)となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金の支払によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成27年4月24日に発表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果 会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま す。

(2) 追加情報

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

		(単位・日ガロ)
	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,601	2, 056
受取手形及び売掛金	30, 658	37, 807
商品	17, 569	11, 348
前渡金	3, 620	4, 289
繰延税金資産	183	157
預け金	_	10, 605
その他	120	285
流動資産合計	53, 753	66, 550
固定資産		
有形固定資産	71	67
無形固定資産	73	50
投資その他の資産	704	708
固定資産合計	850	825
資産合計	54, 603	67, 376
負債の部		
流動負債		
買掛金	8, 243	12, 816
短期借入金	15, 955	18, 304
未払法人税等	360	374
賞与引当金	113	107
未払金	2, 202	7, 663
その他	800	590
流動負債合計	27,675	39, 859
固定負債		
長期借入金	2,000	2, 000
退職給付に係る負債	253	267
その他	36	37
固定負債合計	2, 290	2, 304
負債合計	29, 966	42, 160
純資産の部		
株主資本		
資本金	2, 054	2, 054
資本剰余金	1, 984	1, 984
利益剰余金	19, 911	20, 416
自己株式	<u> </u>	△(
株主資本合計	23, 948	24, 454
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	76	9:
繰延ヘッジ損益	△46	
為替換算調整勘定	588	586
その他の包括利益累計額合計	618	683
非支配株主持分		79
純資産合計	24, 637	25, 215
負債純資産合計	54, 603	67, 376

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

		(一区・口2011)
	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
売上高	84, 374	102, 383
売上原価	82, 165	99, 933
売上総利益	2, 208	2, 450
販売費及び一般管理費	983	1, 107
営業利益	1, 224	1, 343
営業外収益		
受取利息	0	1
受取配当金	4	4
仕入割引	159	84
持分法による投資利益	2	_
その他	5	4
営業外収益合計	172	95
営業外費用		
支払利息	53	52
債権売却損	17	32
支払手数料	28	9
為替差損	214	172
持分法による投資損失	_	9
その他	19	10
営業外費用合計	333	286
経常利益	1, 064	1, 152
税金等調整前四半期純利益	1,064	1, 152
法人税等	373	364
四半期純利益	691	787
非支配株主に帰属する四半期純利益	13	10
親会社株主に帰属する四半期純利益	677	777

(四半期連結包括利益計算書) (第2四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益	691	787
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△16	14
繰延ヘッジ損益	$\triangle 125$	50
為替換算調整勘定	69	$\triangle 2$
その他の包括利益合計	<u></u>	62
四半期包括利益	618	850
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	601	840
非支配株主に係る四半期包括利益	16	9

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (継続企業の前提に関する注記) 該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 該当事項はありません。

4. 補足情報

(品目別販売実績)

		前第2四半期連結累計期間			当第2四半期連結累計期間				Ē	前連結会計	年度
品目別		(自 平成26年4月1日		(自	(自 平成27年4月1日			(自	平成26年	4月1日	
		至 平成26年9月30日)		至	至 平成27年9月30日)		(%)	至	平成27年:	3月31日)	
		金額(百	万円)	構成比 (%)	金額	(百万円)	構成比 (%)		金額	(百万円)	構成比 (%)
	メモリー		51, 949	61.6		54, 456	53. 2	4.8		101, 216	58.9
	システムLSI		8, 428	10.0		15, 187	14.8	80. 2		18, 487	10.7
半導	· 算体小計		60, 377	71.6		69, 643	68.0	15. 3		119, 703	69.6
液晶	量デバイス		14, 204	16.8		20,010	19. 5	40. 9		28, 363	16. 5
その)他		9, 791	11.6		12,730	12. 5	30.0		23, 816	13. 9
	合計		84, 374	100.0		102, 383	100.0	21. 3		171,882	100.0

(メモリー半導体)

PC向けDRAMの売上が落ち込み、中国市場でのNAND FLASHの売上が伸び悩んだものの、携帯電話(スマートフォン)向けにDRAM及びMCP、サーバー向けにDRAMを拡販したことから、この分野の売上高は544億56百万円(前年同期比4.8%増)となりました。

(システムLSI)

中国市場で携帯電話(スマートフォン)向けCIS(CMOSイメージセンサ)、国内では液晶テレビ向けにDDI(ディスプレイドライバIC)の売上が伸びたことにより、この分野の売上高は151億87百万円(前年同期比80.2%増)となりました。

(液晶デバイス)

国内ではモニター及びサイネージ向けの売上の維持に努め、中国市場で現地テレビメーカー向けに液晶パネルの拡販を行い、この分野の売上高は200億10百万円(前年同期比40.9%増)となりました。

(その他)

価格競争の激化により、テレビ用バックライト向けLEDの売上が減少したものの、タブレット・スマートフォン用有機ELパネルの受注が増加したこともあり、この分野の売上高は127億30百万円(前年同期比30.0%増)となりました。